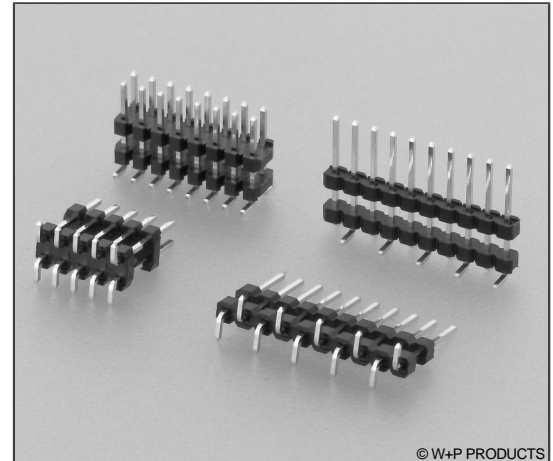


SMT-Sandwich-Stiftleisten RM 2,00mm, 1-/2-reihig SMT Dual Body Pin Headers, 2.00mm Pitch, Single/Double Row

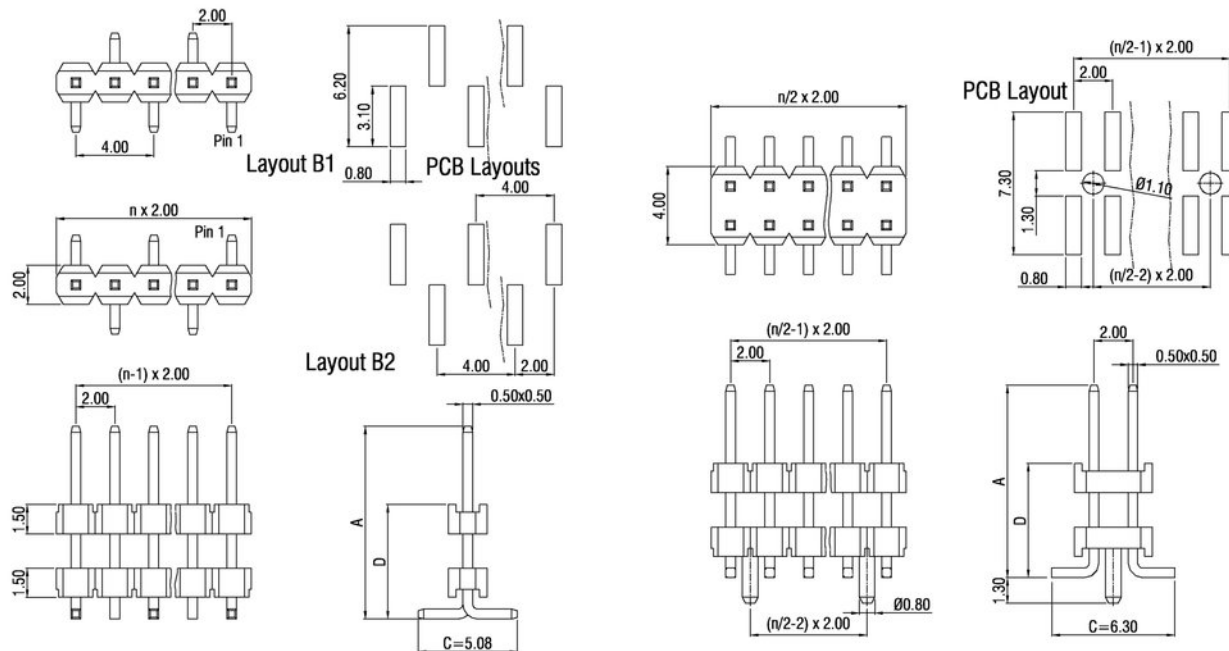
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung <i>0.50mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV _{DC}
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V _{AC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +125°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
7450 7451 4160 6192 etc.
Weitere siehe Kapitel B
» ch. B for more



Series	Contacts*	Rows*	Dimensions*	Dim.*	Plating*	Loc. Pegs*	Packaging*
7352	80	11	01	6,35	50	10	ST
	03-40 Einreihig <i>Single row</i> 04-80 2-reihig <i>Double row</i>	11 Layout B1 12 Layout B2 20 Zweireihig <i>Double row</i>	01 A=10,70mm 02 A=7,85mm 03 A=11,86mm 04 A=12,37mm 05 A=15,37mm 06 A=17,35mm 07 A=9,86mm 99 Kundenspez. <i>Customer-spec.</i>	D [in mm]	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 50 Verzinnt <i>Tin plated</i> 60 Sel. Au/Sn <i>Duplex plating</i>	00 Ohne Pos.hilfen <i>W/o loc. pegs</i> 10 Mit Pos.hilfen <i>(nur 2-reihig)</i> <i>With loc. pegs</i> <i>(double row only)</i>	ST PPST PPTR (Option)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*
PPST In Stangen mit P&P-Pads / *In tubes with P&P-Pads*
PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

